nexthardware.com

a cura di: **Gian Paolo Collalto - giampa - 22-12-2010 19:24**

Il LanBoy Air di Antec si aggiudica l'iF Product Design Award 2011

LINK (https://www.nexthardware.com/news/case/3194/il-lanboy-air-di-antec-si-aggiudica-lif-product-design-award-2011.htm)

Un case esclusivo open-frame e modulare dalla massima configurabilità e flessibilità si aggiudica il premio per l'eccellenza del design

COMUNICATO STAMPA

↔

↔

Fremont, CA â€“ 22 dicembre 2010 â€“ In occasione del 25↔° anniversario, Antec, Inc., leader mondiale nel settore dei componenti e degli accessori per il gioco, ha annunciato oggi che il telaio LanBoy Air si è aggiudicato il prestigioso iF (International Forum) Product Design Award 2011 per l'eccellenza della qualità del design nella categoria "Computer"

LanBoy Air di Antec è un avanzato telaio open-frame completamente modulare che garantisce la massima configurabilità e flessibilità per chi gioca, gli assemblatori di computer e gli utenti di workstation. Presenta avanzatissime funzioni di raffreddamento e circolazione dell'aria, un interno completamente riconfigurabile con alloggiamenti modulari per unità , supporti per PSU e schede madri che offrono una struttura estremamente versatile che garantisce, a sua volta, condizioni ottimali per la ventilazione e la personalizzazione. Include inoltre AirMountâ„¢, un sistema brevettato di sospensioni HDD per l'attenuazione delle vibrazioni e del rumore.

"Siamo estremamente felici del fatto che LanBoy Air sia stato premiato dal comitato iF per il design e

l'innovazione", ha commentato Scott Richards, Senior Vice President di Antec. "Il nostro team di progettazione si merita un applauso poiché questo telaio rappresenta la massima creatività e l'impegno per offrire ai clienti i prodotti ad alte prestazioni che si aspettano da Antec".↔

Con questo premio, LanBoy Air entra a fare parte di una esclusiva serie di prodotti riconosciuti per la lavorazione, la funzionalità e l'innovazione ai massimi livelli.↔

Dal 1953, gli annuali iF Design Award vengono assegnati al miglior design di prodotti di qualsiasi settore. Quest'anno, un team di oltre 20 giurati di fama internazionale, fra cui progettisti e imprenditori, ha scelto i vincitori fra più di 2.756 prodotti di 1.121 partecipanti provenienti da 43 paesi. Il comitato ufficiale ha presentato 993 prodotti con l'iF Design Award.

Il telaio LanBoy Air, vincitore del premio, verrà presentato al CES 2011 dal 6 al 9 gennaio 2011. Il telaio verrà esposto presso lo stand di Antec al Las Vegas Convention Center, South Hall 1, sezione Home Theater / Home Systems, Stand 21802. Qui sarà possibile ottenere ulteriori informazioni, nonché provare le più recenti novità di Antec nel settore dei case, alimentatori, sistemi di raffreddamento per notebook e accessori.

Per informazioni sugli eventi, visitare la pagina Facebook ufficiale di Antec all'indirizzo www.facebook.com/AntecEurope (http://www.facebook.com/AntecEurope) oppure il blog ufficiale di Antec blog all'indirizzo http://blog.antec.com/ (http://blog.antec.com/). Ulteriori informazioni sugli iF (International Forum) Design Award sono disponibili all'indirizzo www.ifdesign.de/awards_product_index_e (http://www.ifdesign.de/awards_product_index_e).

↔

↔

Questa documento PDF è stato creato dal portale nexthardware.com. Tutti i relativi contenuti sono di esclusiva proprietà di nexthardware.com.
Informazioni legali: https://www.nexthardware.com/info/disclaimer.htm